

高音質オーディオ用電源 IC シリーズ

高音質オーディオ用リニアレギュレータ

BD37201NUX

概要

BD37201NUX は、高音質なオーディオセットに最適な低ノイズ(3.3 μ Vrms)のリニアレギュレータであり、2.7 V ~ 5.5 V で動作し最大 500 mA の負荷供給能力を持ちます。BD37201NUX は低ノイズに加え高い PSRR と優れた入力過渡変動特性を持つため、DC/DC コンバータ出力の安定化にも適しており、D/A コンバータ(DAC)やクロックジェネレータなどの高精度アナログ回路への電源供給に最適です。BD37201NUX のスタンバイ電流は 0.02 μ A(Typ)と小さく待機時の消費電力を大幅に削減することができます。

特長

- 超低ノイズ、高い PSRR 特性
- イネーブルによりスタンバイ状態との切り替え可能
- 外付け容量によるソフトスタート機能
- 低電圧誤動作防止機能、過電流保護機能、温度保護機能内蔵

用途

- ハイレゾオーディオ機器
- DAC、クロックジェネレータ用電源

重要特性

- 入力電圧範囲 : 2.7 V ~ 5.5 V
 - 出力電圧範囲 : 1.0 V ~ 4.5 V
 - 出力電流 : 500 mA(Max)
 - 出力電圧ノイズ^(Note 1) : 3.3 μ Vrms(10 Hz ~ 100 kHz, Typ)
 - PSRR^(Note 2) : 90 dB(1 kHz, Typ), 55 dB(1 MHz, Typ)
 - 入力過渡応答 : 3 mV(1.0 V/ μ s, Typ)
 - スタンバイ電流 : 0.02 μ A(Typ)
 - 動作温度範囲 : -10 °C ~ +85 °C
- (Note 1) C_{BC} =10 μ F, V_{OUT} =1 V, I_{OUT} =500 mA 設定時
(Note 2) C_{OUT1} =47 μ F, C_{OUT2} =100 μ F, V_{OUT} =1 V, I_{OUT} =500 mA 設定時

パッケージ

VSON008X2030

W(Typ) x D(Typ) x H(Max)

2.00 mm x 3.00 mm x 0.60 mm



VSON008X2030

基本アプリケーション回路

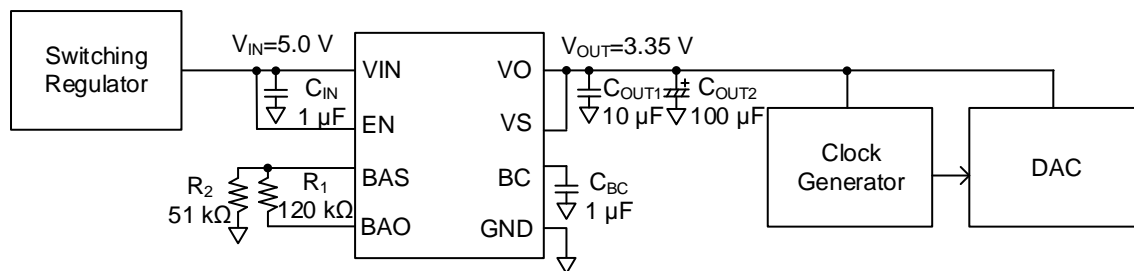


Figure 1. 基本アプリケーション回路図 (出力 3.35 V 設定時)

端子配置図

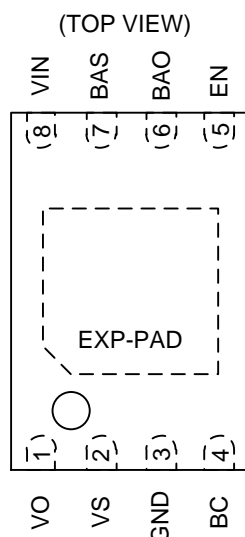


Figure 2. 端子配置図

端子説明

端子番号	記 号	機 能
1	VO	電圧出力端子
2	VS	出力フィードバック用端子
3	GND	接地端子
4	BC	バイパス用コンデンサ接続端子
5	EN	EN 端子
6	BAO	設定電圧出力端子
7	BAS	設定電圧フィードバック用端子
8	VIN	電圧入力端子
-	EXP-PAD	EXP-PAD は GND パターンに接続してください。

ブロック図

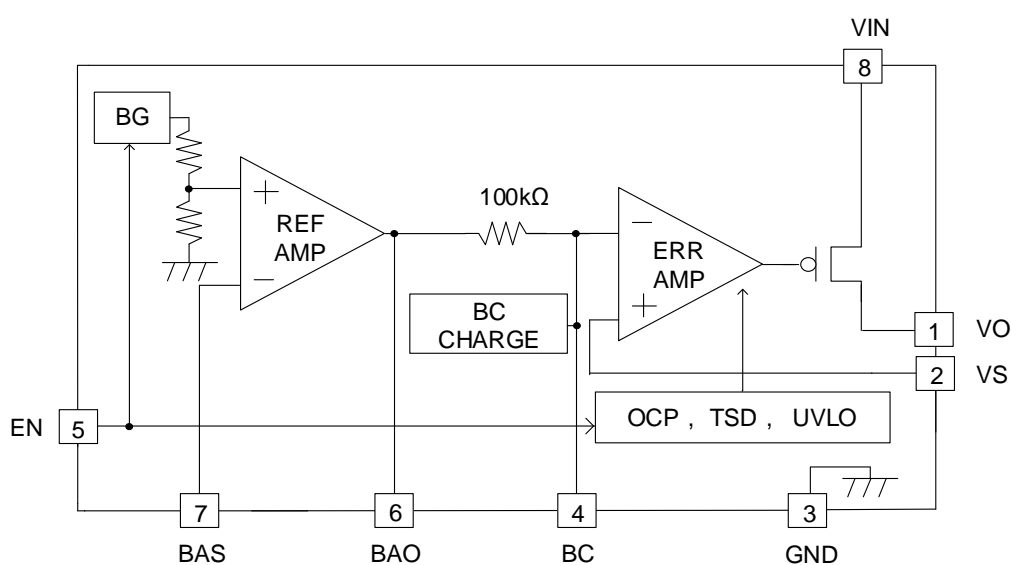


Figure 3. ブロック図

各ブロック動作説明

1. イネーブル

EN を L とすることで、IC をスタンバイ状態にすることができます。スタンバイ状態では出力を OFF し静止状態となるためスタンバイ時の消費電力を小さくすることが可能です。

2. 立ち上がり時、立ち下がり時シーケンス

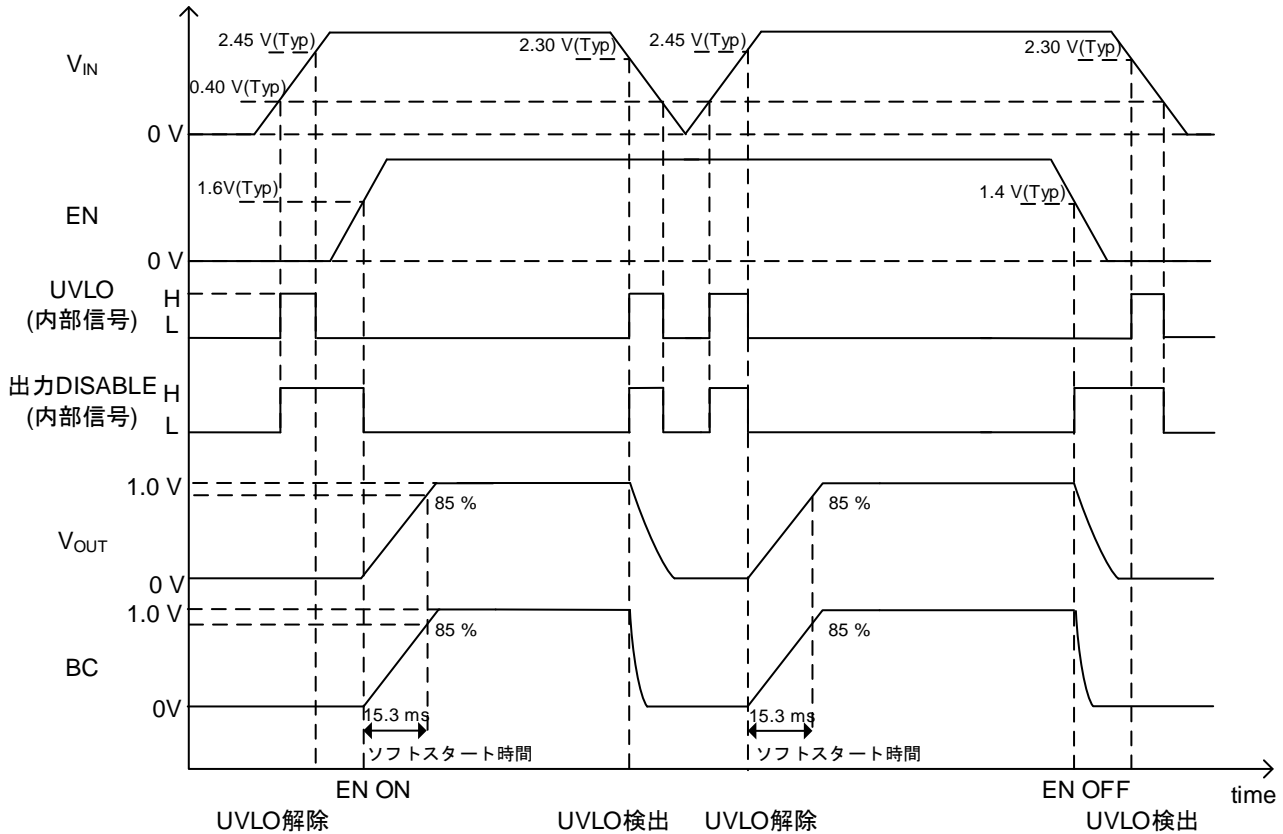


Figure 4. V_{IN}/EN 立ち上がり・立ち下がり時シーケンス波形(BC 容量 1 μF 、 V_{OUT} 1.0 V 設定時)

出力電圧は、EN が H かつ低電圧誤動作防止機能(UVLO)が解除されると起動します。
 また出力電圧は UVLO が検出される、または EN が L となるとレギュレート動作を止めます。
 V_{IN} は EN よりも必ずしも先に立ち上げる必要はありません。
 V_{IN} 入力電圧のスルーレートは最大 1 V/ μs の速さ以下となるようにしてください。

3. ソフトスタート機能

BD37201NUX では BC に接続された容量により、EN 立ち上げ時に出力のラッシュカレントを防ぐため、ソフトスタートさせることが可能です。
 立ち上がり速度は回路内部に存在するチャージ電流 100 μA (Typ)と BC に接続された容量値、出力設定電圧に依存し、BC 容量が 1 μF ・出力電圧設定が 1.0 V の時で 15.3 ms(Max)程度、出力電圧設定を 3.35 V とすると 45.4 ms(Max)程度となります。上記は目安値であり入力電圧が出力電圧を下回る場合や、入出力電圧条件によってはソフトスタート時間が変化する可能性があります。

ソフトスタート中に EN オン/オフが繰り返される信号が入力された場合、ソフトスタート機能は動作しません。
 EN オン操作後上記ソフトスタート時間の間は、EN オフ/オフ操作をしない制御にする必要があります。

4. REFAMP

REFAMP は出力電圧を設定します。設定方法については[アプリケーション部品選定方法](#)を参照ください。

各ブロック動作説明 — 続き

5. BC

REFAMP 出力電圧は、回路内部にある 100 k Ω と外付けの BC 容量により低ノイズ化されます。
また、BC の外付け容量はソフトスタート回路も兼ねており、この値により出力の立ち上がり速度が調整可能です。
容量値を大きくすることでノイズレベルは低下しますが、ソフトスタート時間が長くなります。

6. ERRAMP

ERRAMP は REFAMP で設定された電圧をボルテージ・フォロアで出力します。ここで VS は必ず VO と接続するようにしてください。また、VS へは供給先から電圧帰還を返すことで VO 経路上のパターン抵抗による電圧低下を減少させることが可能です。

絶対最大定格(Ta=25 °C)

項 目	記号	定 格	単位
電源電圧(PIN 8)	V _{IN}	-0.3 ~ +7.0	V
端子電圧(PIN 1, 2, 4, 5, 6, 7)	V _{PIN}	-0.3 ~ +7.0	V
保存温度範囲	T _{stg}	-55 ~ +150	°C
ジャンクション温度	T _{jmax}	150	°C

注意 1: 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただくようご検討をお願いします。

注意 2: 最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

熱抵抗 (Note 3)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1 層基板 (Note 5)	4 層基板 (Note 6)	
VSON008X2030				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ _{JA}	308.3	69.6	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ (Note 4)	Ψ _{JT}	43	10	°C/W

(Note 3) JESD51-2A(Still-Air)に準拠。

(Note 4) ジャンクションからパッケージ（モールド部分）上面中心までの熱特性パラメータ。

(Note 5) JESD51-3 に準拠した基板を使用。

(Note 6) JESD51-5,7 に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1 層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.57 mmt

1 層目（表面）銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μm

測定基板	基板材	基板寸法	サーマルビア (Note 7)	
			ピッチ	直径
4 層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.6 mmt	1.20 mm	Φ0.30 mm

1 層目（表面）銅箔		2 層目、3 層目（内層）銅箔		4 層目（裏面）銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μm	74.2 mm□（正方形）	35 μm	74.2 mm□（正方形）	70 μm

(Note 7) 貫通ビア。全層の銅箔と接続する。配置はランドパターンに従う。

推奨動作条件

項 目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V _{IN}	2.7	-	5.5	V
出力電圧設定可能範囲	V _{OUT}	1.0	-	4.5	V
出力電流 (Note 8)	I _{OUT}	-	-	500	mA
動作温度	T _{opr}	-10	+25	+85	°C

(Note 8) T_{jmax} を超えないこと。

動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
入力コンデンサ (Note 9)	C _{IN}	0.47	1	-	μF	フィルム・コンデンサ推奨
出力コンデンサ 1 (Note 9, 10)	C _{OUT1}	1	10	-	μF	フィルム・コンデンサ推奨
出力コンデンサ 2 (Note 9, 10)	C _{OUT2}	4.7	100	-	μF	電解コンデンサ推奨
BC コンデンサ (Note 9, 10)	C _{BC}	0.01	1	-	μF	フィルム・コンデンサ推奨

(Note 9) コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性、等を考慮して最小値を下回らないように設定してください。

(Note 10) コンデンサについては [16 ページ](#)、[17 ページ](#) のアプリケーション部品選定方法を参照して決定するようにしてください。

電気的特性

(特に指定のない限り $V_{IN}=V_{OUT}+1.0\text{ V}$ または 2.7 V のいずれか高い方 $V_{OUT}=1.0\text{ V}$ $T_a=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $C_{OUT1}=10\text{ }\mu\text{F}$ $C_{OUT2}=100\text{ }\mu\text{F}$ $C_{BC}=1\text{ }\mu\text{F}$ $I_{OUT}=5\text{ mA}$ $V_{EN}=V_{IN}$)

項 目	記号	最小	標準	最大	単位	条 件
回路電流	I_{CC}	-	1.33	2.3	mA	-
スタンバイ電流	I_{STB}	-	0.02	1.0	μA	$V_{IN}=5.5\text{ V}$, $V_{EN}=0\text{ V}$
基準電圧	V_{REF}	0.99	1.00	1.01	V	BAO Voltage
ラインレギュレーション	D_{VI}	-	1	20	mV	$V_{IN}=2.7\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$
ロードレギュレーション	D_{VL}	-	3	20	mV	$I_{OUT}=0\text{ A} \sim 500\text{ mA}$
入出力間電圧差	V_{SAT}	-	0.2	0.5	V	$I_{OUT}=500\text{ mA}$, $V_{OUT}=3.35\text{ V}$
PSRR 1 kHz	$PSRR_{1kHz}$	-	90	-	dB	$f=1\text{ kHz}$
PSRR 1 MHz	$PSRR_{1MHz}$	-	55	-	dB	$f=1\text{ MHz}$, $C_{OUT1}=47\text{ }\mu\text{F}$
出力ノイズ電圧	V_{NOISE}	-	3.3	-	μV_{rms}	$BW=10\text{ Hz} \sim 100\text{ kHz}$, $C_{BC}=10\text{ }\mu\text{F}$, $I_{OUT}=500\text{ mA}$
過電流保護機能検出値	I_{OCP}	500	-	-	mA	-
UVLO 検出電圧	V_{UVLOH}	2.10	2.30	2.50	V	-
UVLO 解除電圧	V_{UVLOL}	2.25	2.45	2.65	V	-
EN 入力 H レベル	V_{THENH}	2.20	-	V_{IN}	V	-
EN 入力 L レベル	V_{THENL}	0.00	-	0.60	V	-
EN 流入電流	I_{EN}	-	1.23	2.10	μA	$V_{EN}=3\text{ V}$

特性データ(参考データ)

(特に指定のない限り $V_{IN}=V_{OUT}+1.0\text{ V}$ または 2.7 V のいずれか高い方 $V_{OUT}=1.0\text{ V}$ $T_a=25\text{ }^{\circ}\text{C}$ $C_{OUT1}=10\text{ }\mu\text{F}$ $C_{OUT2}=100\text{ }\mu\text{F}$ $C_{BC}=1\text{ }\mu\text{F}$ $I_{OUT}=5\text{ mA}$ $V_{EN}=V_{IN}$)

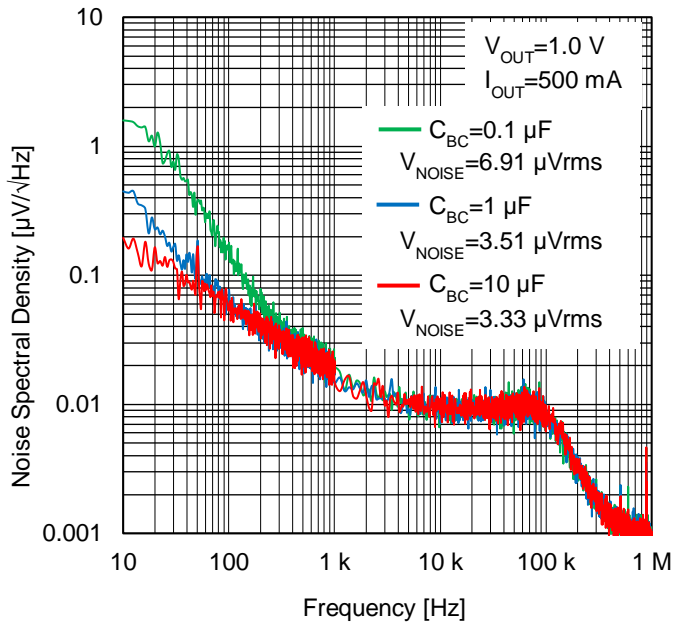


Figure 5. Noise Spectral Density vs Frequency
($V_{OUT}=1.0\text{ V}$)

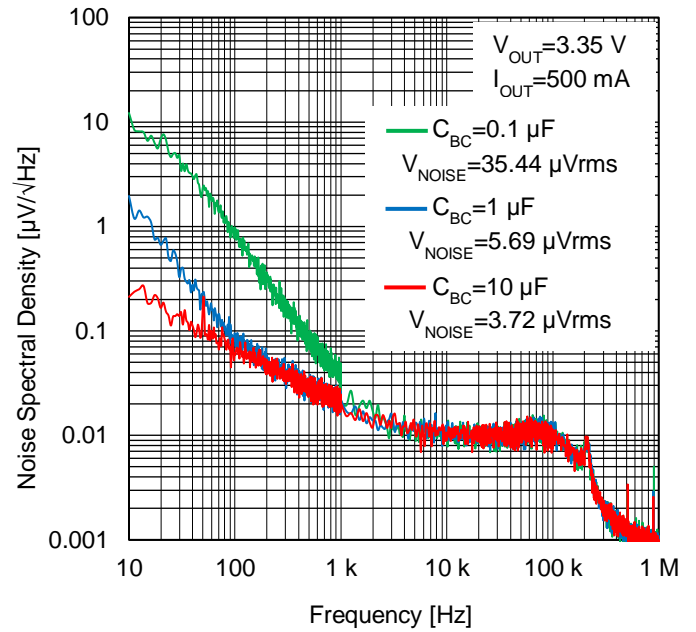


Figure 6. Noise Spectral Density vs Frequency
($V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

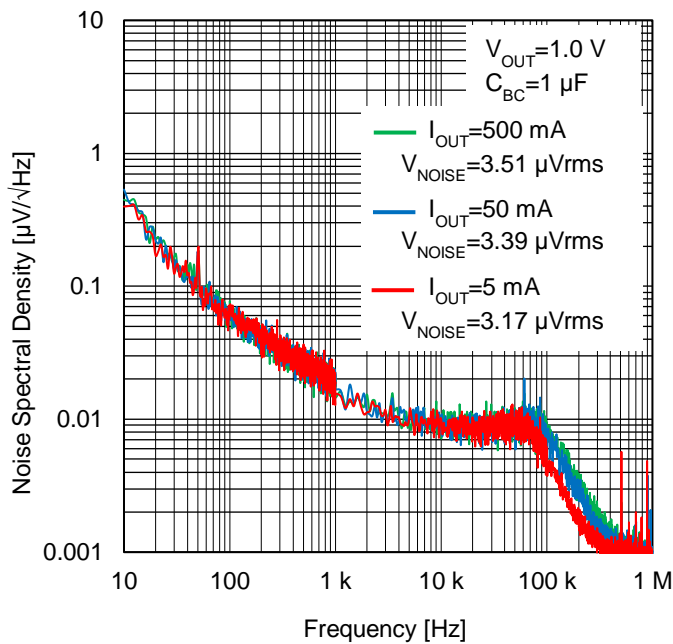


Figure 7. Noise Spectral Density vs Frequency
($V_{OUT}=1.0\text{ V}$)

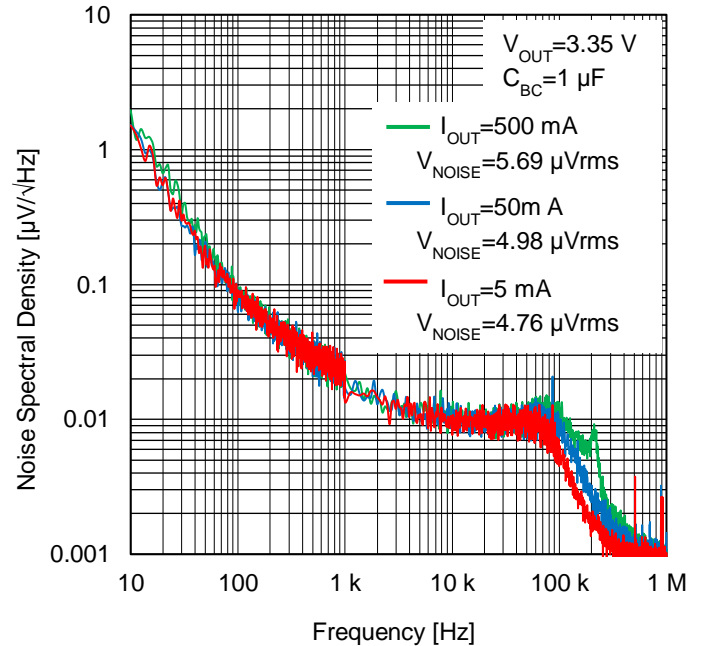


Figure 8. Noise Spectral Density vs Frequency
($V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

特性データ(参考データ) — 続き

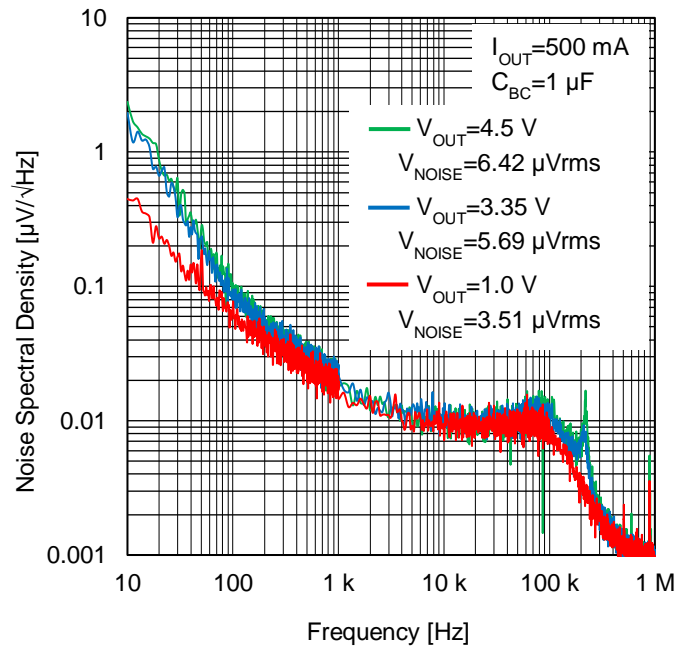


Figure 9. Noise Spectral Density vs Frequency

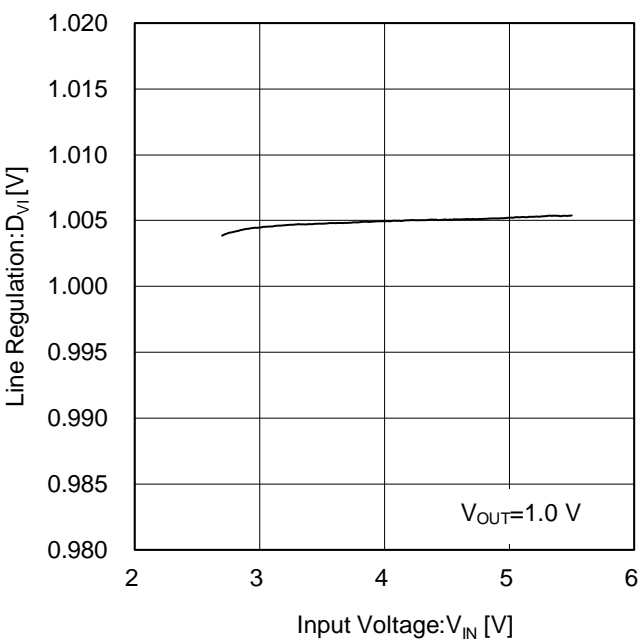


Figure 10. Line Regulation (D_{VI}) ($V_{\text{OUT}} = 1.0 \text{ V}$)

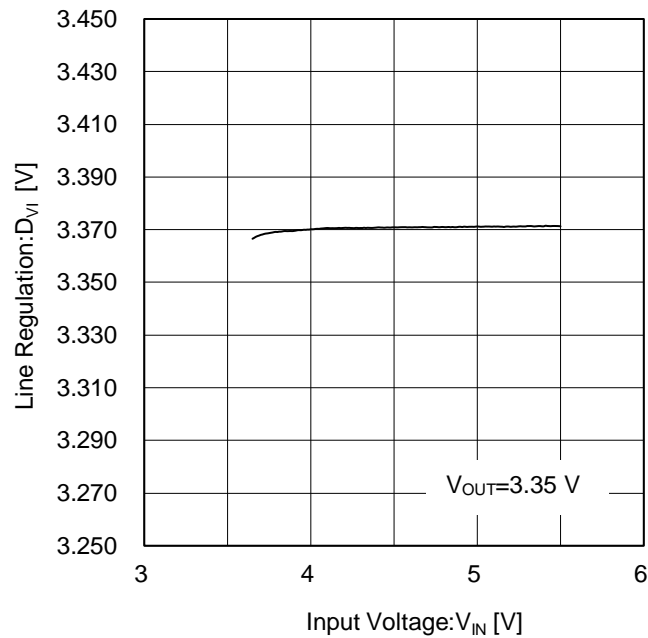


Figure 11. Line Regulation (D_{VI}) ($V_{\text{OUT}} = 3.35 \text{ V}$)

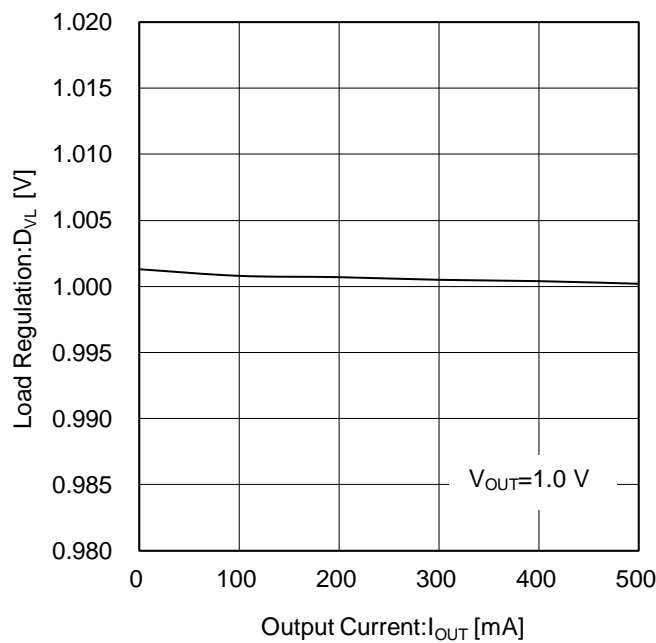


Figure 12. Load Regulation (D_{VL}) ($V_{\text{OUT}} = 1.0 \text{ V}$)

特性データ(参考データ) — 続き

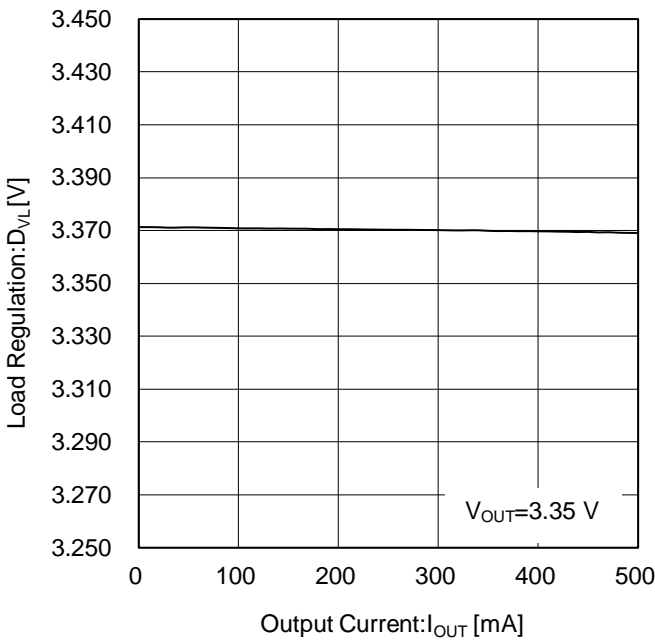


Figure 13. Load Regulation (D_{VL})
($V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

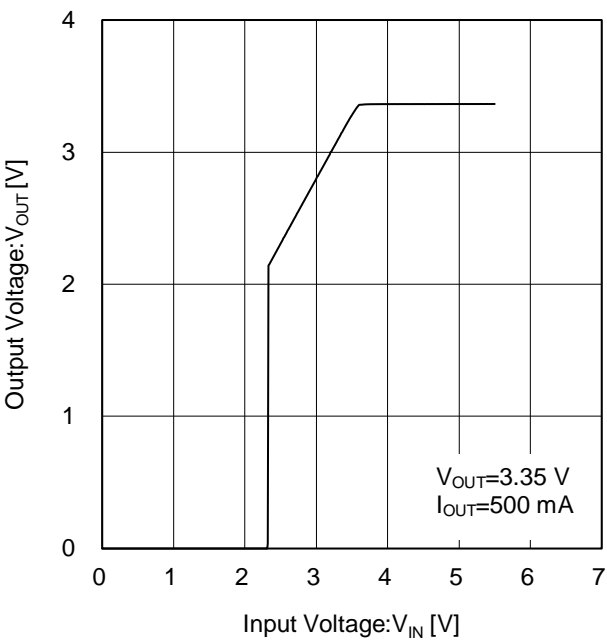


Figure 14. Output Voltage vs Input Voltage
($V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

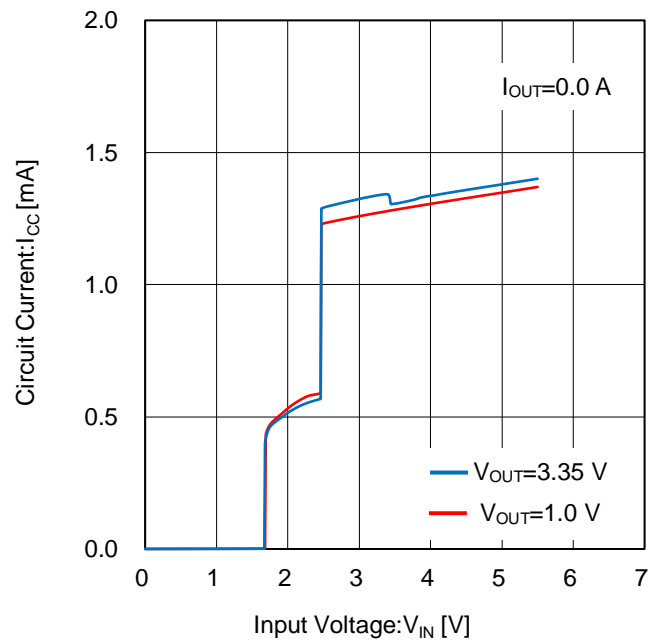


Figure 15. Circuit Current vs Input Voltage

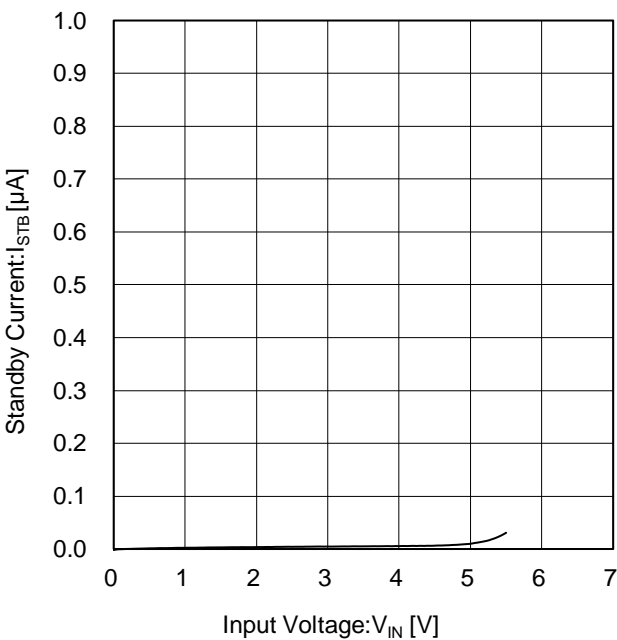


Figure 16. Standby Current vs Input Voltage

特性データ(参考データ) — 続き

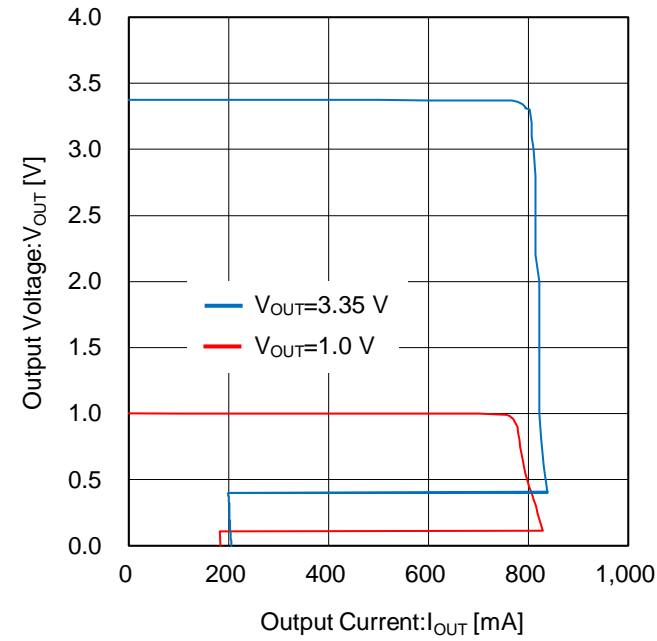


Figure 17. Output Voltage vs Output Current

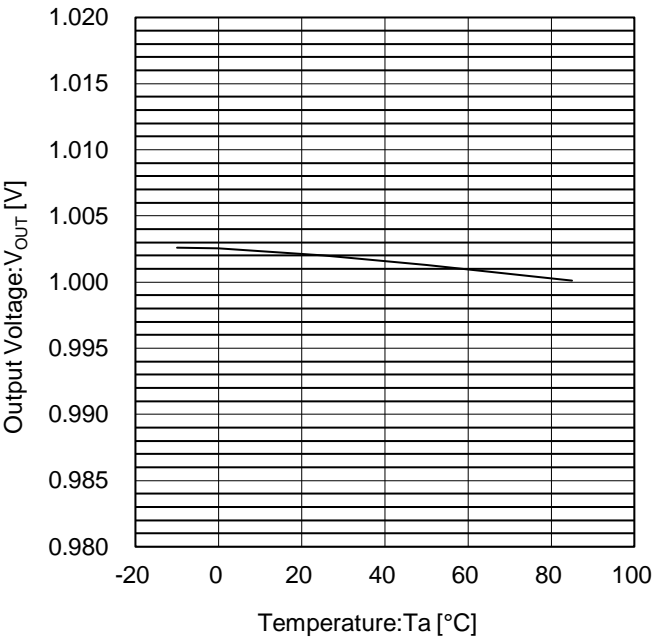


Figure 18. Output Voltage vs Temperature ($V_{OUT}=1.0$ V)

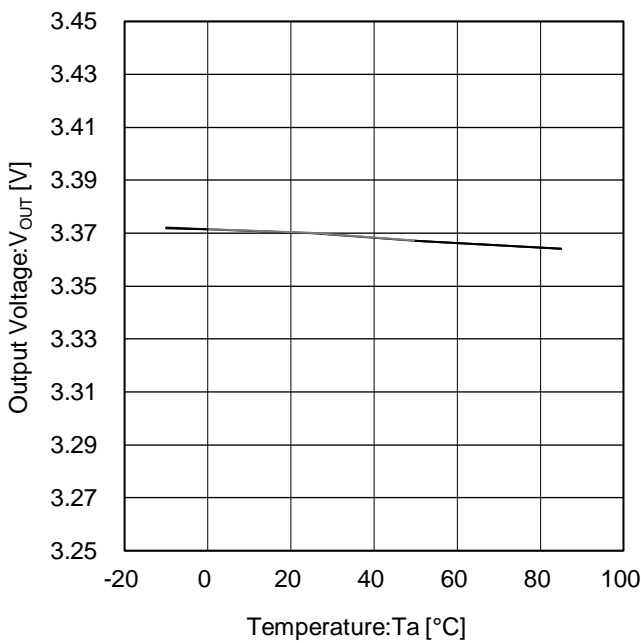


Figure 19. Output Voltage vs Temperature ($V_{OUT}=3.35$ V)

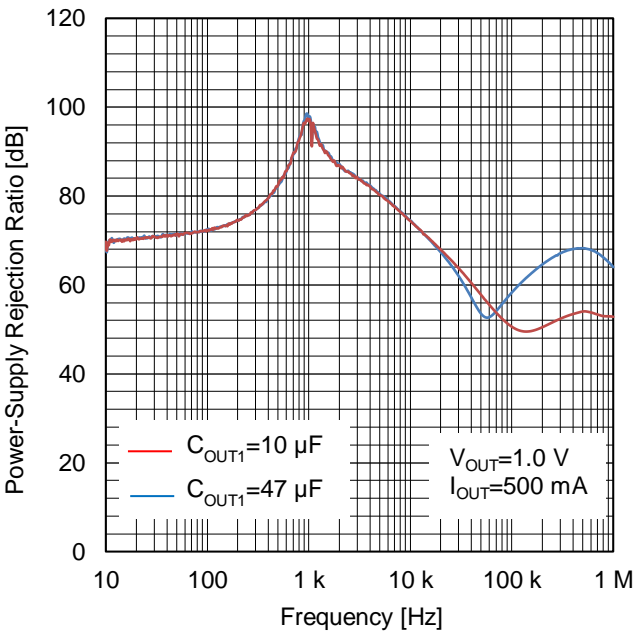
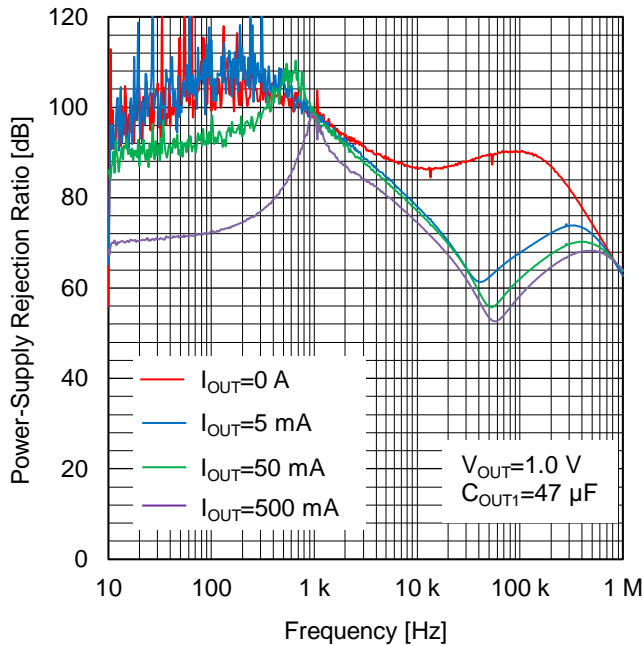
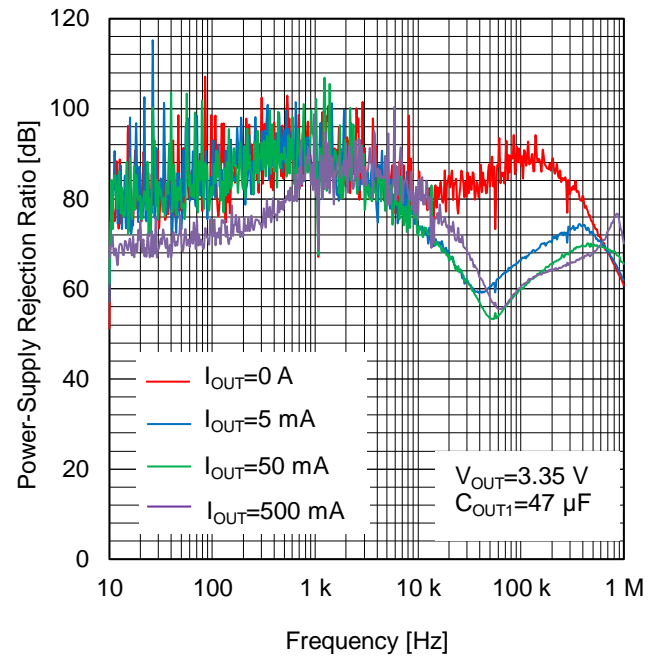
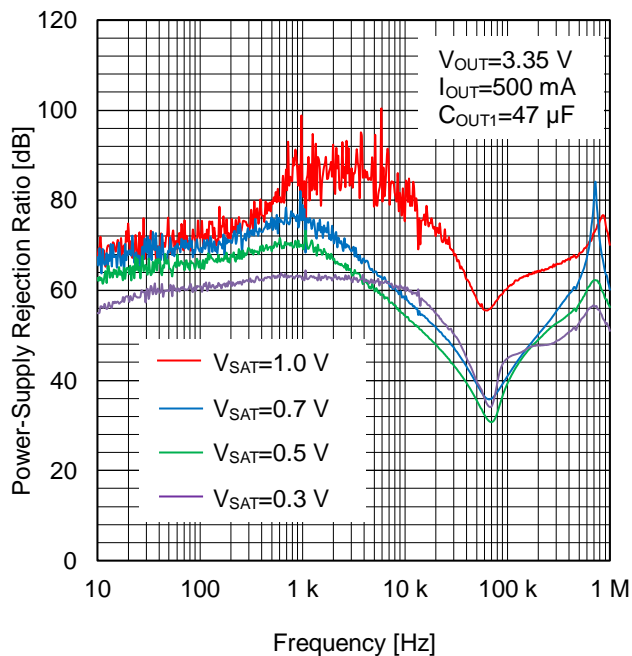
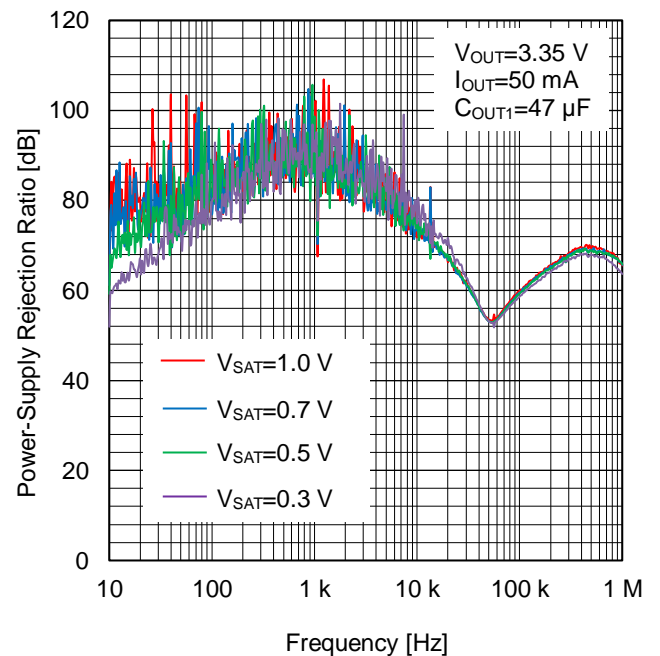


Figure 20. Power-Supply Rejection Ratio ($V_{OUT}=1.0$ V)

特性データ(参考データ) — 続き

Figure 21. Power-Supply Rejection Ratio ($V_{OUT}=1.0$ V)Figure 22. Power-Supply Rejection Ratio ($V_{OUT}=3.35$ V)Figure 23. Power-Supply Rejection Ratio ($V_{OUT}=3.35$ V)Figure 24. Power-Supply Rejection Ratio ($V_{OUT}=3.35$ V)

特性データ(参考データ) — 続き

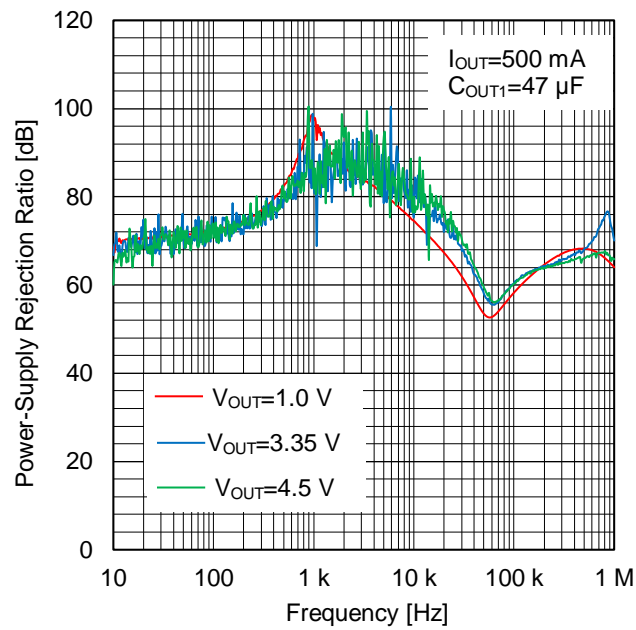


Figure 25. Power-Supply Rejection Ratio

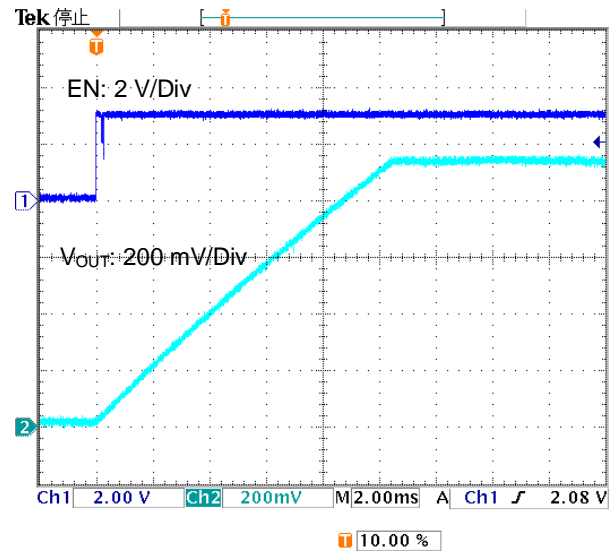


Figure 26. ソフトスタート
($V_{OUT}=1.0\text{ V}$)

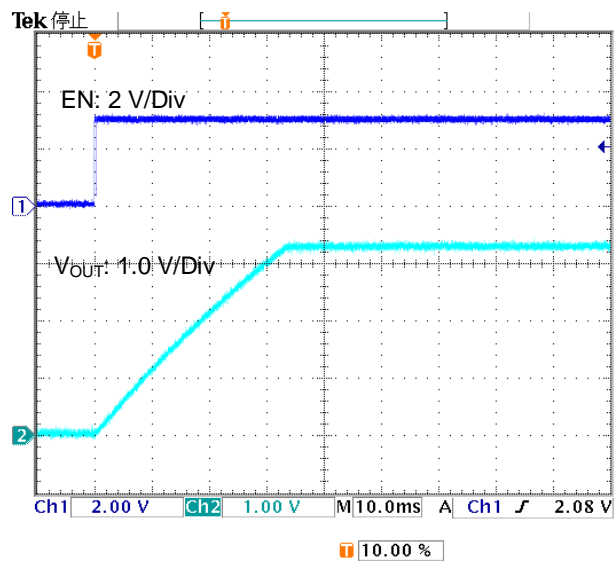


Figure 27. ソフトスタート
($V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

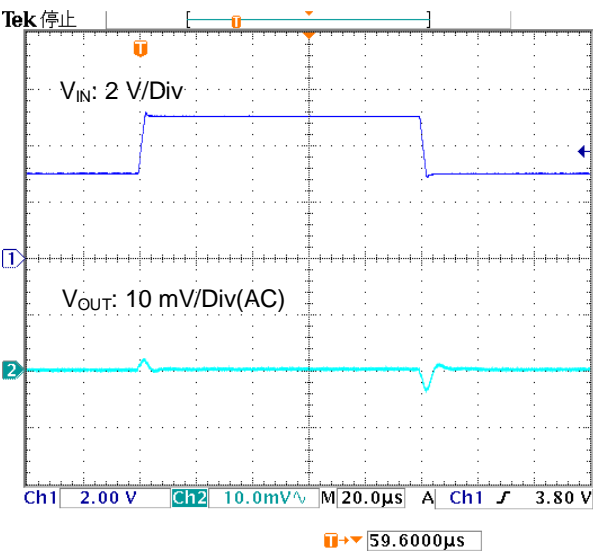


Figure 28. 入力過渡応答
($I_{OUT}=500\text{ mA}$ Slew Rate=1 V/μs $V_{OUT}=1.0\text{ V}$)

特性データ(参考データ) — 続き

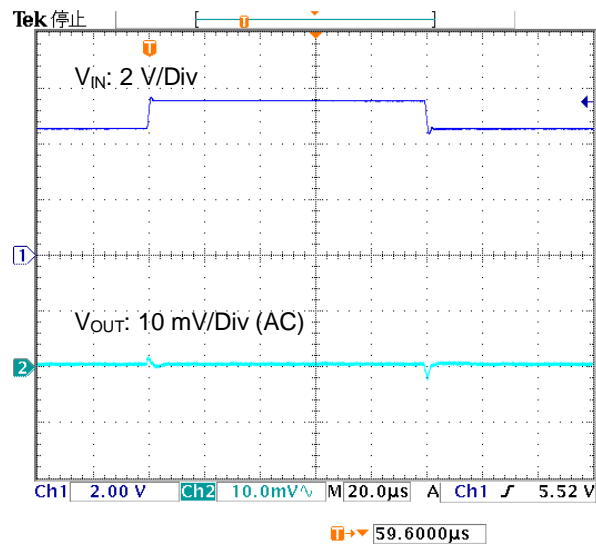


Figure 29. 入力過渡応答
($I_{OUT}=500\text{ mA}$ Slew Rate=1 V/ μs $V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

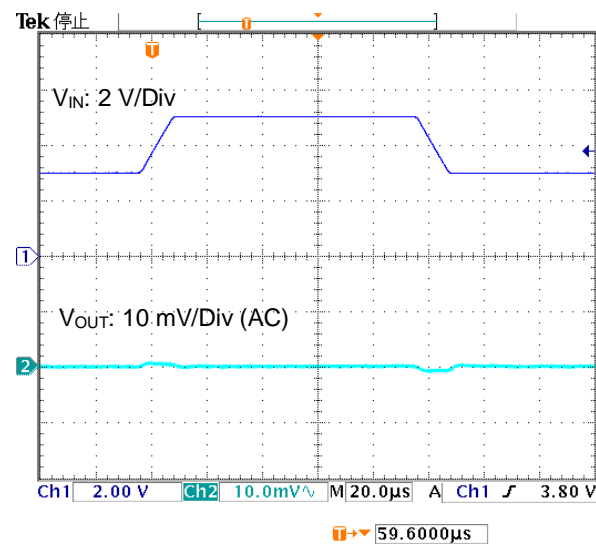


Figure 30. 入力過渡応答
($I_{OUT}=500\text{ mA}$ Slew Rate=0.2 V/ μs $V_{OUT}=1.0\text{ V}$)

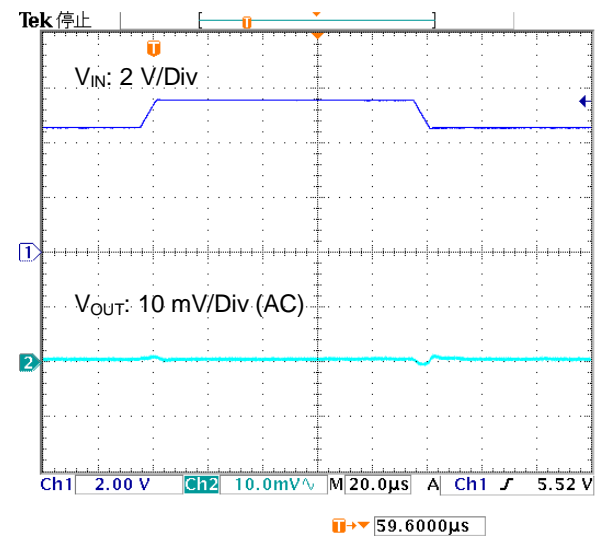


Figure 31. 入力過渡応答
($I_{OUT}=500\text{ mA}$ Slew Rate=0.2 V/ μs $V_{OUT}=3.35\text{ V}$)

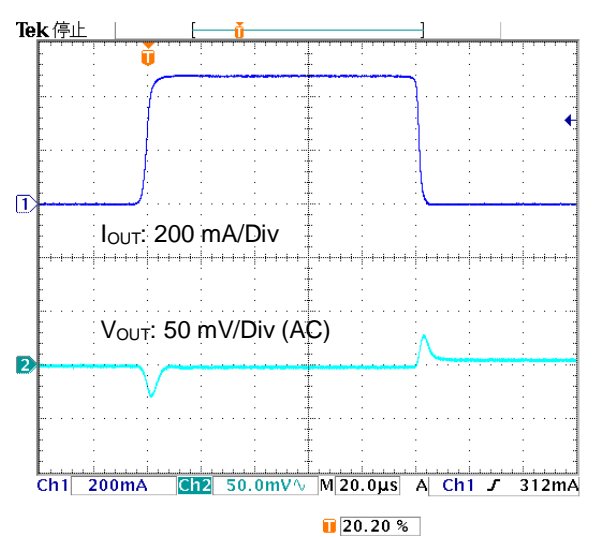


Figure 32. 負荷過渡応答
($I_{OUT}=0\text{ mA} \sim 500\text{ mA}$ $V_{OUT}=1.0\text{ V}$)

特性データ(参考データ) — 続き

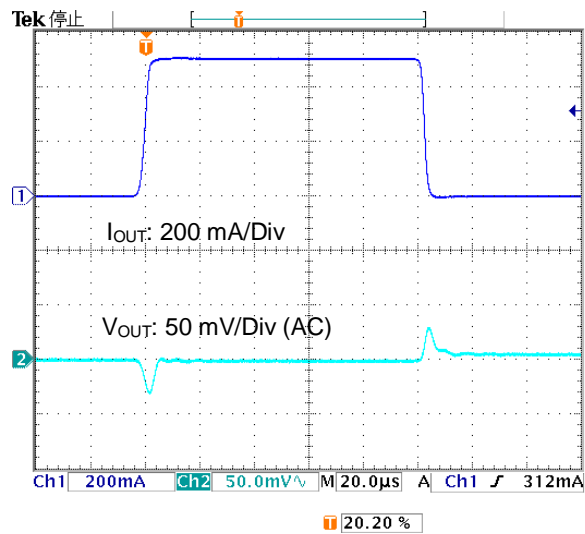
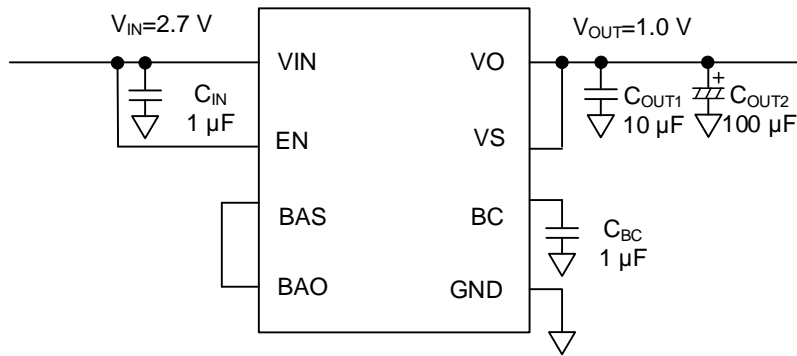


Figure 33. 負荷過渡応答
($I_{OUT}=0 \text{ mA} \sim 500 \text{ mA}$ $V_{OUT}=3.35 \text{ V}$)

応用回路例

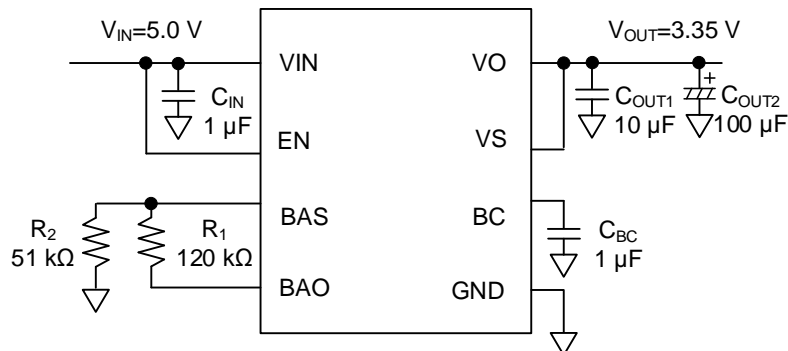


部品	メーカー	値	品番
C _{IN}	Rubycon	1 μF	16MU105M3216
C _{OUT1}	Rubycon	10 μF	16MU106M4532
C _{OUT2}	東信工業	100 μF	1CUTSJ101M0
C _{BC}	Rubycon	1 μF	16MU105M3216

(Note) 本応用例は一例であり、実際の設定においてはセットでの十分な評価、検証の上、決定願います。

(Note) コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性、等を考慮して最小値を下回らないように設定してください。

Figure 34. 応用回路例 1 (出力 1.0 V 設定時)



部品	メーカー	値	品番
R1	ROHM	120 kΩ	MCR03EZPD1203
R2	ROHM	51 kΩ	MCR03EZPD5102
C _{IN}	Rubycon	1 μF	16MU105M3216
C _{OUT1}	Rubycon	10 μF	16MU106M4532
C _{OUT2}	東信工業	100 μF	1CUTSJ101M0
C _{BC}	Rubycon	1 μF	16MU105M3216

(Note) 本応用例は一例であり、実際の設定においてはセットでの十分な評価、検証の上、決定願います。

(Note) R₁, R₂ の値は R₁ + R₂ が 100 kΩ 以上となるようにしてください。また電圧設定用抵抗は 1 % 精度以下の物を推奨します。

(Note) コンデンサの容量は温度特性、DC バイアス特性、等を考慮して最小値を下回らないように設定してください。

Figure 35. 応用回路例 2 (出力 3.35 V 設定時)

アプリケーション部品選定方法

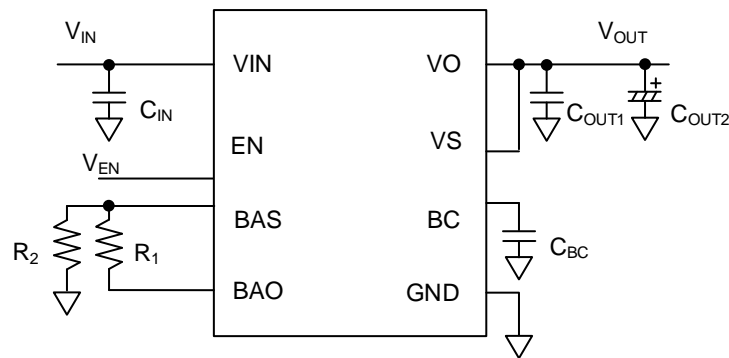


Figure 36. アプリケーション部品選定方法説明図

1. 出力電圧設定

出力電圧を設定するには、BAO-BAS 間に R_1 の抵抗、BAS-GND 間に R_2 の抵抗を接続してください。 R_1 , R_2 の値は $R_1 + R_2$ が 100 k Ω 以上となるようにしてください。また電圧設定用抵抗は 1 % 精度以下の物を推奨します。1V 設定の場合は BAO と BAS はショートしてご使用ください。

$$V_{OUT} = V_{BAS} \times \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad [V]$$

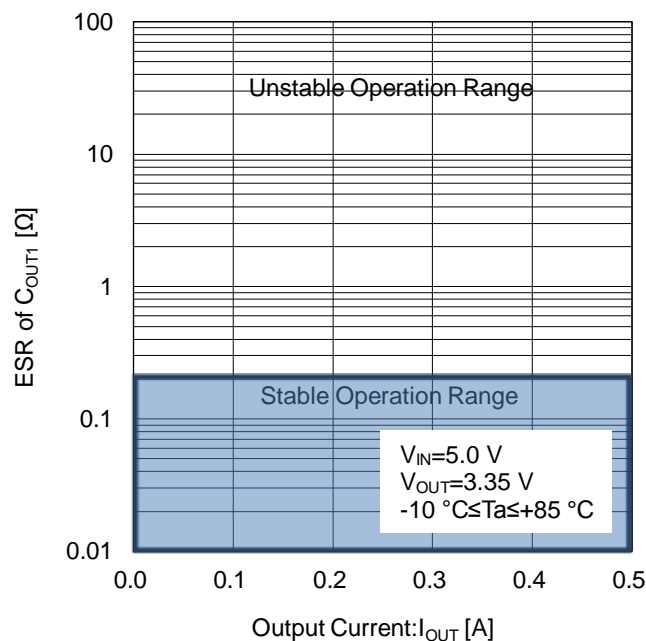
$$V_{BAS} = 1.0 \quad [V] \text{ (Typ)}$$

2. 出力コンデンサ C_{OUT1} , C_{OUT2}

出力コンデンサ C_{OUT1} は電圧変動や温度特性、ばらつきなどを十分に加味し 1 μF 以上の容量を選択するようにしてください。また、出力コンデンサ C_{OUT2} は電圧変動や温度特性、ばらつきなどを十分に加味し 4.7 μF 以上の容量を選択するようにしてください。出力コンデンサは VO と GND 間のなるべくピンに近い位置に配置し、定格電圧は出力電圧に対し十分にマージンを持って設定してください。

出力コンデンサ C_{OUT1} の ESR は IC 動作の安定性に影響します。出力コンデンサの選定には、Figure 37 の Stable Operation Range を合わせてご参照ください。このデータは出力コンデンサ C_{OUT1} に 10 μF のフィルム・コンデンサと ESR を直列に、出力コンデンサ C_{OUT2} に 100 μF の電解コンデンサを並列に組み合わせて測定しています。

このグラフの安定領域は、IC 単体及び抵抗負荷によるものであり、実際には PCB 基板の配線インピーダンス、入力電源のインピーダンス、負荷のインピーダンスによって変化するため、必ずご使用になる最終状態での十分なお確認をお願いいたします。

Figure 37. ESR of C_{OUT1} vs Output Current

アプリケーション部品選定方法 — 続き

3. 入力コンデンサ C_{IN} の選択

入力コンデンサは電圧変動や温度特性、ばらつきなどを十分に加味し 0.47 μ F 以上の容量を選択するようにしてください。

入力コンデンサも入力端子と GND 間のなるべく近い位置にコンデンサを入れるようにしてください。

また、コンデンサの定格電圧は入力電圧に対し十分にマージンを持って設定してください。

4. フィルタコンデンサ C_{BC} の選択

フィルタコンデンサ C_{BC} は、内蔵された抵抗とのローパスフィルタを形成し出力電圧に現れるノイズを軽減します。

また、フィルタコンデンサ C_{BC} は、ソフトスタート機能を兼ねており起動時のラッシュ電流を制限しています。

その立ち上がり速度は回路内部に存在するチャージ電流 100 μ A(Typ)と BC に接続された容量値、そして出力設定電圧に依存し、容量が 1 μ F・出力電圧設定が 1 V の時で 15.3 ms(Max)程度、出力電圧設定を 3.35 V とすると

45.4 ms(Max)程度となります。

フィルタコンデンサを大きくするとノイズの低減へとつながりますが、ソフトスタート時間は長くなるため適切な定数の設定が必要です。

C_{BC} の容量は以下の計算式を考慮して設計するようにしてください。出力容量によっては正常に起動しない可能性があります。

$$C_{BC} \geq \frac{C_{OUT1} + C_{OUT2}}{1000} \quad [F]$$

入出力等価回路図

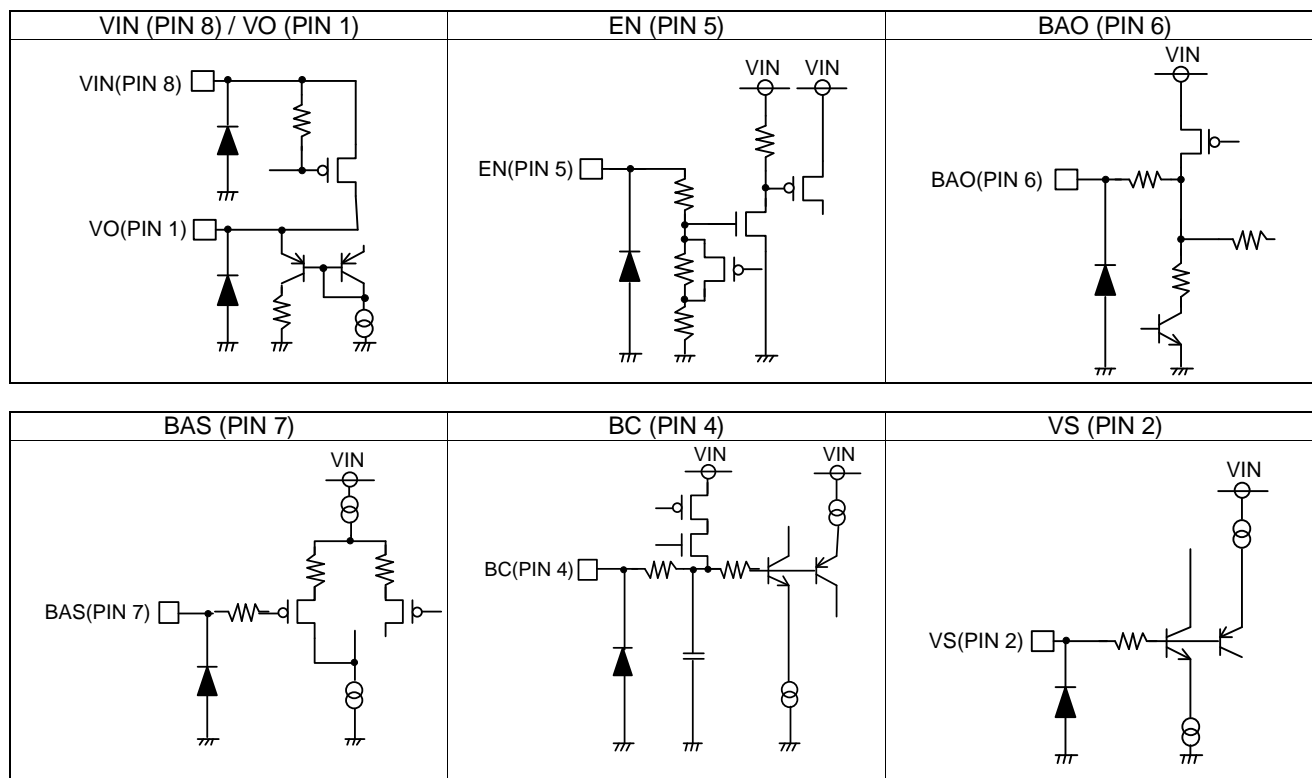
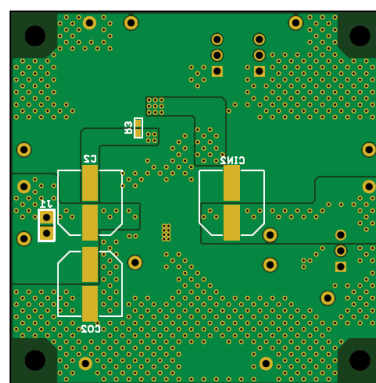
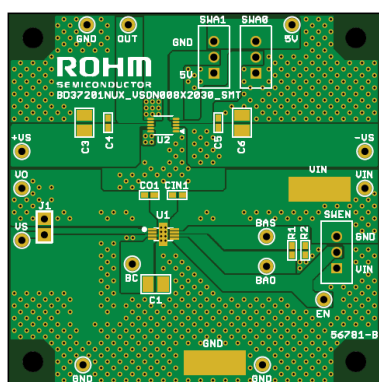


Figure 38. 入出力等価回路図

評価基板レイアウト図



基板表面 基板裏面
(基板サイズ 60 mm x 60 mm、厚さ 1.6 mm、素材 FR-4)

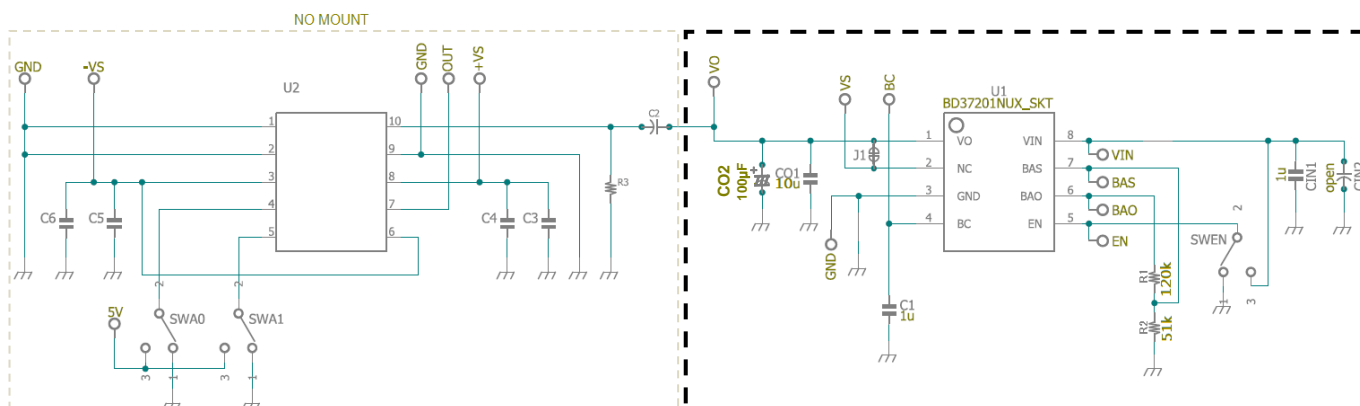


Figure 39. 測定基板回路図

(Note) 上記パターン図には他のデバイスパターンも含まれています。本 IC のマウント位置は U1 です。

使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

6. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

7. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

8. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

9. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

使用上の注意 — 続き

10. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、GND > (端子 A)の時、トランジスタ(NPN)では GND > (端子 B)の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ(NPN)では、GND > (端子 B)の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND(P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

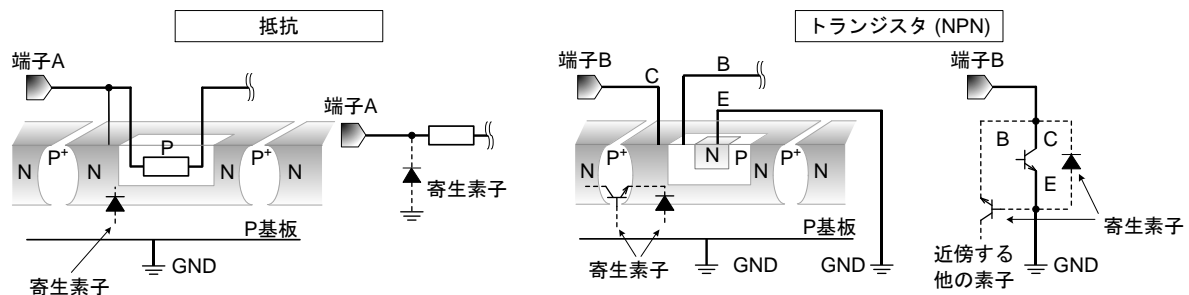


Figure 40. モノリシック IC 構造例

11. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ定数を決定してください。

12. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

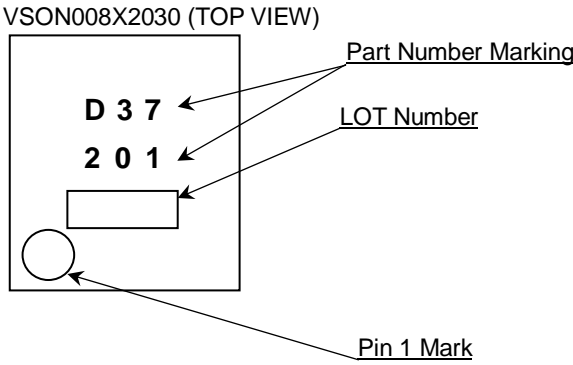
13. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

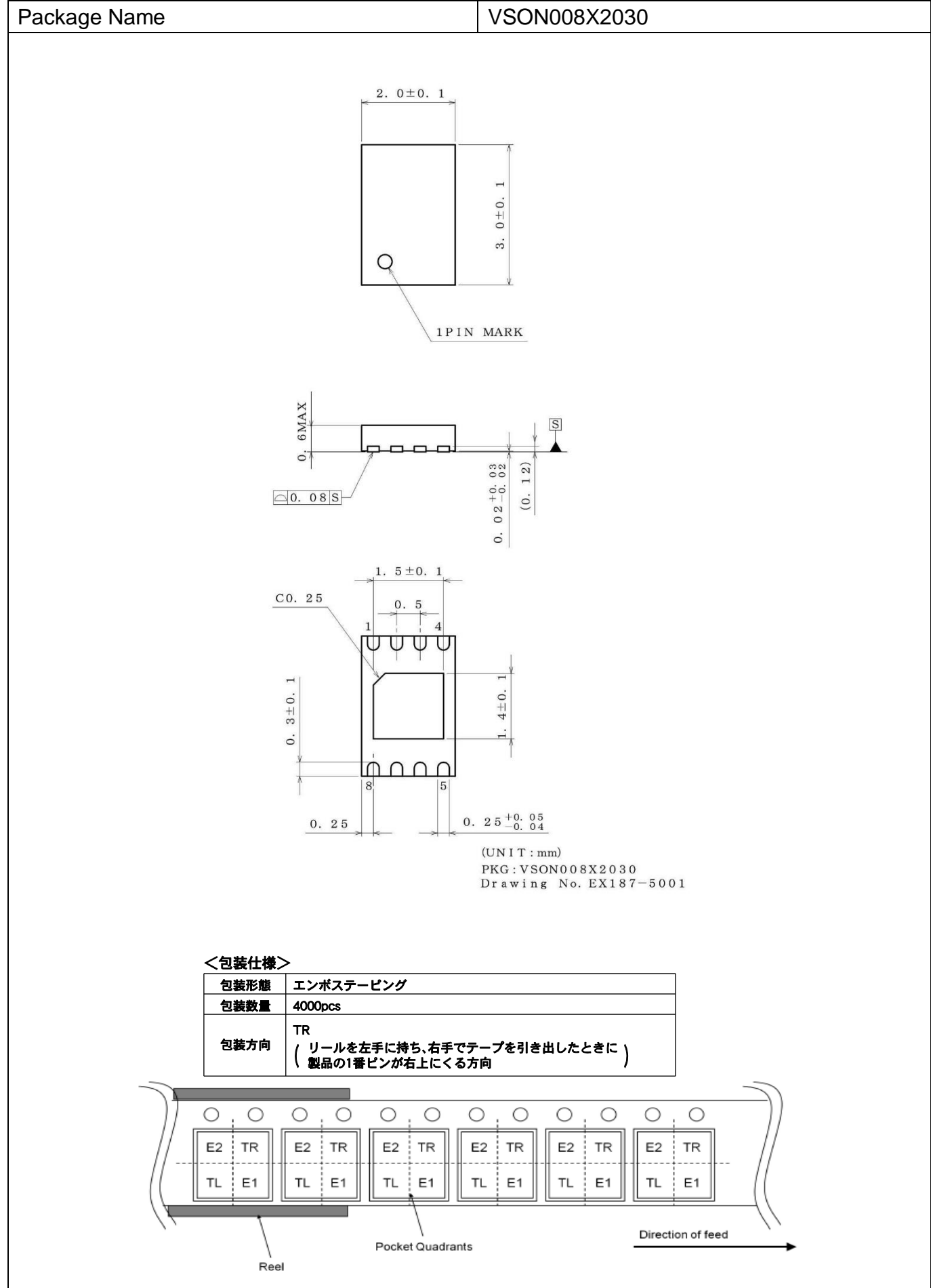
発注形名情報

B D 3 7 2 0 1 N U X										-	T R	
品名										パッケージ NUX: VSON008X2030		包装、フォーミング仕様 TR: エンボステーピング

標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様



改訂履歴

日付	版	変更内容
2016.04.18	001	新規登録
2018.03.19	002	シリーズ名更新 特性データ更新
2018.10.05	003	出力コンデンサ変更 特性データ更新
2019.02.07	004	動作温度範囲変更

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂ 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合（無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。）又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。